

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-115

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 关于新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况概述

公司为满足经营发展需要，有效降低公司财务费用，提升盈利能力，拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）申请不超过人民币 1.5 亿元综合授信额度，担保方式为纯信用担保，授信期限为 1 年。本次综合授信内容包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、国内信用证、融资性保函、商业承兑汇票贴现等综合业务，具体融资金额及利率将根据公司实际资金需求，以公司与民生银行苏州分行签署的融资协议为准，经董事会审议通过后一年以内，授信额度可以循环使用。

#### 二、审议和表决情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》。

#### 三、对公司的影响

本次新增银行综合授信额度符合公司整体利益，有利于公司持续稳定地发展，有助于改善公司当前现金流量及财务状况，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 四、备查文件

- 第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日